

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年12月16日(16.12.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/251050 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/018096

(22) 国際出願日: 2021年5月12日(12.05.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2020-100421 2020年6月9日(09.06.2020) JP

(71) 出願人: 株式会社荏原製作所 (EBARA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 今井 正芳 (IMAI, Masayoshi); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 宮▲崎▼ 充 (MIYAZAKI, Mitsuru); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP).

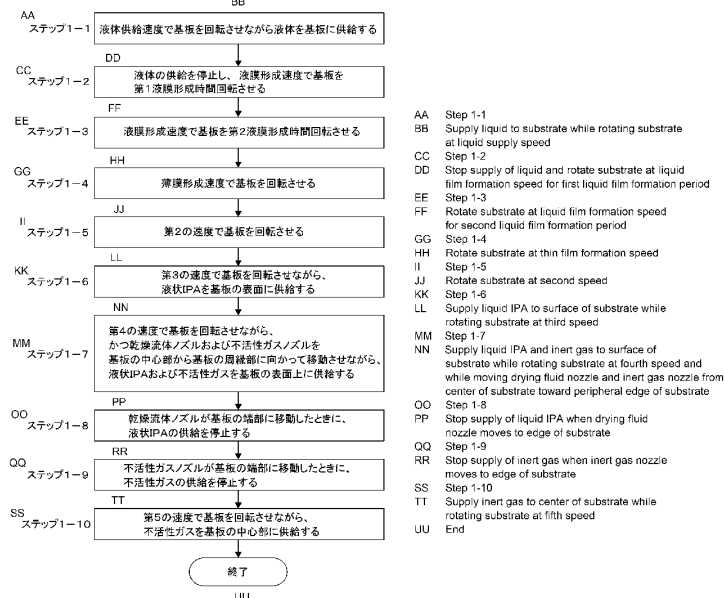
(74) 代理人: 廣澤 哲也, 外 (HIROSAWA, Tetsuya et al.); 〒1600023 東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 8 号 GOWA 西新宿 4 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING DEVICE, COMPUTER-READABLE RECORDING MEDIUM WITH PROGRAM RECORDED THEREIN, AND SUBSTRATE PROCESSING METHOD

(54) 発明の名称: 基板処理装置、プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、および基板処理方法

[図6]



(57) Abstract: The present invention relates to a substrate processing device that processes a substrate. A substrate processing device (1) comprises a control unit (90). The control unit (90) causes a substrate (W) to rotate at a first speed, and then causes the substrate (W) to rotate at a second speed. After causing the substrate (W) to rotate at the second speed, the

[続葉有]

KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

control unit (90) causes a drying fluid to be supplied for a prescribed period from a drying fluid nozzle (30) to the substrate (W) while causing the substrate (W) to rotate at a third speed. The control unit (90) causes the drying fluid nozzle (30) to be moved from the center of the substrate (W) towards the peripheral edge of the substrate (W) while continuing the supply of the drying fluid from the drying fluid nozzle (30).

(57) 要約: 本発明は、基板を処理する基板処理装置に関する。基板処理装置(1)は、制御部(90)を備える。制御部(90)は、第1の速度で基板(W)を回転させた後、第2の速度で基板(W)を回転させる。制御部(90)は、第2の速度で基板(W)を回転させた後、第3の速度で基板(W)を回転させながら、乾燥流体ノズル(30)から基板(W)に所定時間だけ乾燥流体を供給させる。制御部(90)は、乾燥流体ノズル(30)からの乾燥流体の供給を継続させながら、基板(W)の中心部から基板(W)の周縁部に向かって乾燥流体ノズル(30)を移動させる。